

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 30 日 (30.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/059033 A1

- (51) 国際特許分類⁷: **C08L 71/12**, 51/04, C08K 7/06 (74) 代理人: 廣田 浩一 (HIROTA, Koichi); 〒1510053 東京都渋谷区代々木 1-3 8-2 ミヤタビル 8 階 山の手合同国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018473
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 10 日 (10.12.2004) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-421163
2003 年 12 月 18 日 (18.12.2003) JP (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ライオン株式会社 (LION CORPORATION) [JP/JP]; 〒1308644 東京都墨田区本所 1 丁目 3 番 7 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長澤 義信 (NAGASAWA, Yoshinobu) [JP/JP]; 〒1308644 東京都墨田区本所 1 丁目 3 番 7 号 ライオン株式会社内 Tokyo (JP). 江幡 勝由 (EBATA, Katsuyoshi) [JP/JP]; 〒1308644 東京都墨田区本所 1 丁目 3 番 7 号 ライオン株式会社内 Tokyo (JP). 戸堀 悦雄 (TOBORI, Norio) [JP/JP]; 〒1308644 東京都墨田区本所 1 丁目 3 番 7 号 ライオン株式会社内 Tokyo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CONDUCTIVE THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION AND FORMED ARTICLE USING SAME

(54) 発明の名称: 導電性熱可塑性樹脂組成物及びそれを用いた成形品

(57) Abstract: Disclosed is a conductive thermoplastic resin composition having high heat resistance, flame retardance, high strength, high rigidity and excellent dimensional stability, which composition is suitably used as a material for various electrical and electronic components. Also disclosed is a formed article obtained by using such a conductive thermoplastic resin composition. The conductive thermoplastic resin composition contains a polyphenylene ether resin, a butadiene-styrene graft copolymer and a carbon fiber. The formed article is obtained by shaping this conductive thermoplastic resin composition.

(57) 要約: 本発明は、高耐熱性、難燃性、高強度、及び高剛性であり、かつ寸法安定性に優れており、各種電気及び電子部品用部材に好適に利用可能である導電性熱可塑性樹脂組成物、及び該導電性熱可塑性樹脂組成物を用いた成形品を提供することを目的とする。このため、ポリフェニレンエーテル樹脂、ブタジエン-スチレングラフト共重合体、及び炭素繊維を含有してなる導電性熱可塑性樹脂組成物、及び該導電性熱可塑性樹脂組成物を成形してなる成形品を提供する。

WO 2005/059033 A1